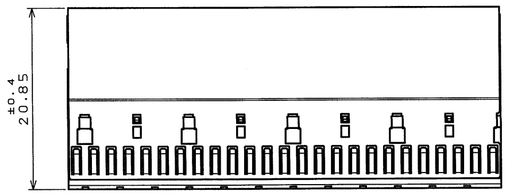
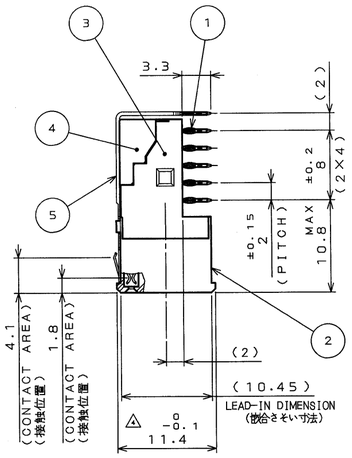
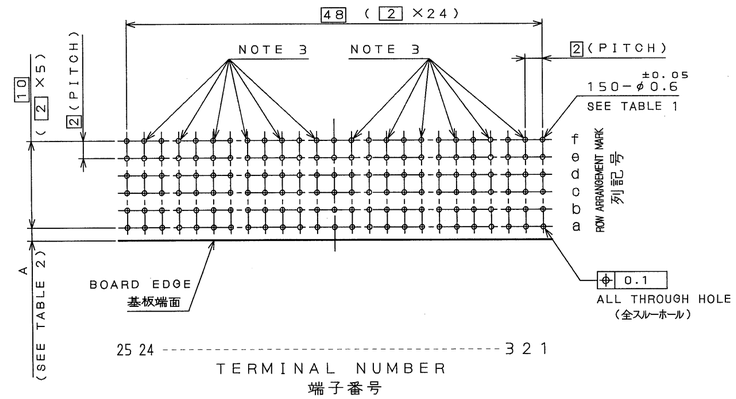
図面番号(DRAWING NO.)
SJ033325

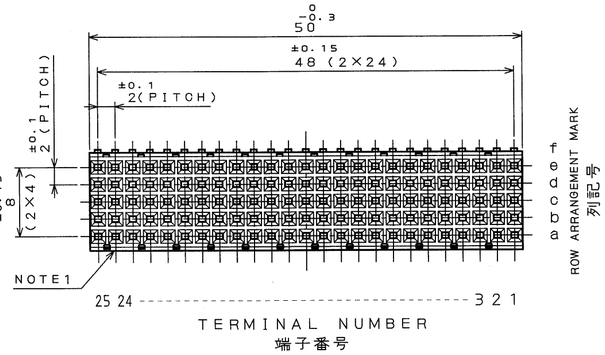
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	4.Aug.1999	43769	REDRAWN, ADDED NOTE4, ETC.	M.ABE	M.KIMURA	S.KASHIWAGI	T.MIZUNO
3	24.Aug.1999	44627	CORRECTED SENTENCE.		M.KIMURA	S.KASHIWAGI	T.MIZUNO
4	1.Feb.2000	45533	REVISED TOLERANCES, ETC.	K.SHIMAZAKI	M.KIMURA	S.KASHIWAGI	H.YASUI
5	14.Jul.2000	46473	REVISED TABLE1		M.KIMURA	S.KASHIWAGI	H.YASUI
6	25.Feb.2003	51599	CORRECTED AN ERROR		M.KIMURA	—	S.Kashiwagi







P.C.B. THROUGH HOLE LOCATION(REF.)
基板スルーホールロケーション(参考)

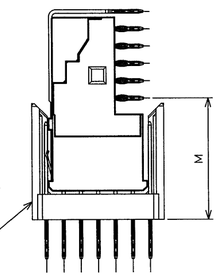


△ DESIGNATION
命名法

△ MJ04-B125FRP-311G

- SERIES シリーズ名
- HOUSING STYLE ハウジングスタイル
- NUMBER OF CONTACTS 芯数
- G:WITH SHIELD PLATE / NONE:NO SHIELD PLATE △ G:シールドプレート有り 無:シールドプレート無し
- DEVELOPMENT CODE 1:5 ROWS FULL LOAD 開発コード 1:5列フル装填
- TERMINAL LENGTH 1:3.3 端子長 1:3.3
- CONTACT AREA GOLD PLATE THICKNESS 接触部Auめっき厚 3:GOLD(0.76μm MIN) 3:Au0.76μm以上
- TERMINATION STYLE P:PRESS-FIT,T:THROUGH HOLE 結線部形状 P:プレスフィット,T:スルーホール
- CONNECTION ORIENTATION R:RIGHT-ANGLE,S:STRAIGHT 接続方向 R:ライトアングル,S:ストレート
- CONTACT TYPE F:SOCKET,M:PIN コンタクトタイプ F:ソケット,M:ピン

MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)



MJ04-B125MSP-***0 CONNECTOR
(SJ033324 MASTER DRAWING)
(SJ033324 代表図面)

M DIMENSION(REF.) M寸法(参考)	14MIN~ 16.5MAX

NOTE1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
注1. 図示の底面にロット番号を表示する。

(EX.) A 8 8 1
- LOT NUMBER OF CURRENT MONTH 当月の生産ロットを示す
- MONTH(RESPECTIVELY, OCT.:O, NOV.:X, DEC.:Y) 月表示 (10月:O,11月:X,12月:Y)
- YEAR (LAST DIGIT ONLY) 年表示 (西歴末尾)
- PRODUCT CODE 製造コード

2. SEE THE DESIGNATION FOR GOLD PLATE THICKNESS OF THE CONTACT AREA.
2. 接触部のAuめっき厚は命名法を参照のこと

3. THE 12 EVEN THROUGH-HOLES IN f-ROW OUT OF 150 THROUGH-HOLES ARE USED FOR THE CONNECTOR EXTRACTION TOOL. AS THE 12 EVEN THROUGH-HOLES ARE NOT NEEDED.
3. スルーホール150箇所の内、f列の端子番号が偶数の12箇所はコネクタの抜き取り治具用の穴であり、無くてもよい。

△ 4. IF TIN-LEAD PLATING DO TO THROUGH HOLE, TIN-LEAD IS 10μm MAX IN THICKNESS. BUT FINISHED HOLE DIAMETER AFTER COPPER PLATING IS φ0.6 +0.05 AND FINISHED HOLE DIAMETER AFTER TIN-LEAD PLATING IS φ0.55 MIN.
△ 4. 銅スルーホールめっき上に半田めっきを行う場合は、半田めっき厚10μm以下とする。但し、銅スルーホールめっき後の仕上径はφ0.6 +0.05 であり、半田めっき後の仕上径はφ0.55以上であること。

△ TABLE1

STARTED DRILL DIAMETER 下穴ドリル径	±0.025 φ0.7
FINISHED HOLE DIAMETER (COPPER PLATING) 仕上径(銅スルーホールめっき)	±0.05 φ0.6 (NOTE 4)
APPLICABLE P.C.B. THICKNESS 適合基板厚	t1.4 MIN t4.2 MAX
COPPER PLATING THICKNESS 銅めっき厚	25μm MIN
P.C.B. MATERIAL 基板材質	GLASS FILLED EPOXY(STANDARD) ガラス布入り エポキシ積層板(標準)

TABLE2

P.C.B THICKNESS 基板厚	A DIMENSION(REF.) A寸法(参考)
t1.4~t3.5	1.6MAX
t3.5~t4.0	1.2MAX
t4.0~t4.2	1.0MAX

TABLE3

CONTACT AREA(NOTE2) 接触部	GOLD OVER NICKEL(1.5μm MIN) Ni(1.5μm以上)上Auめっき
PRESS-FIT AREA プレスフィット部	TIN-LEAD(1.0μm MIN) OVER NICKEL(1.5μm MIN) Ni(1.5μm以上)上SnPb(1.0μm以上)めっき

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
5	SHIELD PLATE	1	COPPER ALLOY	SEE TABLE 3	
4	LOCATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL-94 V-0 GRAY
3	CONTACT HOLDER	25	GLASS FILLED PBT		UL-94 V-0 GRAY
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL-94 V-0 GRAY
1	CONTACT	125	COPPER ALLOY	SEE TABLE 3	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1584-*
第1版(ORIGINAL DATE) 14.Jul.1998
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±0.8; .X ±0.4; .XX ±0.1; .XXX±
角度(ANGLES): X° ±; X°X'±
製図 DR.
担当 CHK. M.KIMURA
査閲 APPD. S.KASHIWAGI
承認 APPD. H.YASUI
重量(WEIGHT)
尺度(SCALE)
シリーズ(SERIES)
名称(TITLE) △ MJ04-B125FRP -311G
SOCKET CONNECTOR
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.) SJ033325
版数(REV.) 6
SIZE A2
CDS-99-170-10387 △

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-213D(98.02)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.